



life.augmented



STPay-Mobile and ST54 SoC assure virtual, secure ticketing and payments



意法半導體推出 STPay-Mobile 行動支付平台 推動靈活、可擴充的虛擬購票和非接支付應用發展

- ❖ STPay-Mobile 服務將 ST54 行動裝置安全系統晶片連到非接觸式購票和支付平台
- ❖ 首例應用利用 Snowball OnBoard™ 平台的公車乘車卡

【台北訊，2021年2月24日】—— 橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出可簡化在手機和穿戴式裝置上實現安全要求嚴格之虛擬乘車卡和支付卡的STPay-Mobile行動支付平台。

STPay-Mobile協助行動裝置製造商利用意法半導體ST54安全系統晶片（SoC）的功能處理非接觸式交易並保護使用者資料、安全證書等敏感資訊。

為突顯STPay-Mobile提供虛擬化應用所帶來的價值，意法半導體推出一個利用Snowball Technology OnBoard™平台開發的公車乘車卡解決方案技術。STPay-Mobile管理服務在ST54系統晶片上執行，與OnBoard™平台搭配使用，讓開發變得更簡便，而購檢票方便的虛擬卡票能夠使用於智慧型手機和穿戴式裝置上。

Snowball執行長暨聯合創始人Ciaran Fisher表示，「ST54產品系列和新的STPay-Mobile服務，

搭配Snowball的OnBoard平台，讓智慧裝置商和公共交通公司能夠利用全球支援最廣泛的非接觸式卡標準開發虛擬購票卡。Snowball和ST在研發智慧、安全、互聯的生活產品服務領域擁有共同的願景。ST安全、高性能半導體和創新OnBoard平台共同推動21世紀智慧城市的發展。」

意法半導體微控制器和數位IC產品部副總裁暨安全微控制器部門總經理Marie-France Li-Sai Florentin 則表示，「我們即將推出STPay-Mobile服務，幫助智慧型手機OEM廠利用ST54 SoC強大的安全性和高效的NFC功能開發下一代產品，推動虛擬購票和支付的未來發展，STPay-Mobile服務結合Snowball的OnBoard平台，創造了一個高度可擴充性，而且靈活的非接支付解決方案，使公共交通公司可以在網絡中導入虛擬乘車卡，無需更改現有系統和基礎設施。」

迄今為止，Snowball的OnBoard平台已被全球超過125個城市的50個公共交通公司選用，包括中國所有的主要城市。該平台可相容於主要品牌之330多種不同型號的智慧型手機和穿戴式裝置。現在，城市覆蓋率超過6.8億人。

技術資訊

ST54的STPay-Mobile Ticketing購票服務可協助行動設備製造商因應全球部署的各類不同的運輸基礎建設，並升級支付解決方案。該平台是開放式開發解決方案，支援所有的公車乘車卡標準，包括 Calypso、ITSO、OSPT 等開放標準、MIFARE Classic®、MIFAREDESFire® 和 MIFAREPlus®等專有標準。

STPay-Mobile Payment服務框架將很快完成萬事達卡和Visa規範認證，這些服務為OEM廠提供一個經過標準組織認證和全面功能驗證的非接觸式支付解決方案，已與MDES (Mastercard Digital Enablement Service) 和VTS (Visa Token Service) 的權杖化平台完全整合。

ST54J SoC單晶片整合了非接觸式前段 (Contactless Front-End, CLF) 電路和安全元件 (Secure Element, SE)，為在行動裝置上實現安全交易打造了一個高效能小尺寸的解決方案。ST54J SoC已投入量產。

MIFARE、MIFARE Classic、MIFARE Plus和MIFARE DESFire是NXP(恩智浦)有限公司的註冊商標，未經許可不得擅自使用。

關於意法半導體

意法半導體 (STMicroelectronics; ST) 擁有46,000名半導體技術、產品和方案的創新和創造者，掌握半導體供應鏈和最先進的製造設備。作為一家獨立的半導體設備製造商，意法半導體與逾十萬客戶、上千合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同打造生態系統，一同攜手應對各種挑戰和機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧、電力和能源管理更高效、物聯網和5G技術應用更廣泛。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：

<http://www.st.com> °